

北京九州一轨环境科技股份有限公司关于召开 2026 年第五次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2026 年 8 月 13 日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
《公司章程》的基本条款
（一）股东类型和名次
2026 年第五次临时股东大会
（二）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026 年 8 月 13 日 14 点 00 分
召开地点：北京市丰台区丽仁福路 3 号院 1 号楼 6 层九州一轨公司第一会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
投票起止时间：自 2026 年 8 月 13 日至 2026 年 8 月 13 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权

序号	议案名称	投票股份类型
非累积投票议案		A/累积投票议案
1	关于全资子公司对外投资进行项目建设的议案	V

1. 说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 7 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的的相关公告。

2. 特别决议议案：议案 1
3. 对中小投资者单独计票的议案：议案 1
4. 涉及关联股东回避表决的议案：无
5. 应单独表决的关联股东名称：无
6. 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会召开注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录股东网络投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份验证，具体操作请见投资者网络投票平台投资者使用指南。
（二）同一表决权通过现场、本网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同种类优先股股份数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下持有的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各股东账户和品种股票的第一次投票结果为准。
（四）股东对所有有议案均表决完成后，方可视为有效表决。
四、会议登记事项
（一）登记时间：2026 年 7 月 29 日下午 2 时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情形详见下文），可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股份代码	股票简称	股票简称	股票代码
A 股	688485	九州一轨		2026-048
（二）公司董事和高级管理人员： （三）公司聘请的律师。 （四）其他人员。 五、会议登记办法 （一）登记手续 1.法人股东由法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书和出席人身份证进行登记。 2.自然人股东本人参会的，凭本人身份证进行登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托本人身份证复印件办理登记。 3.如股东委托非书面授权委托书方式进行登记，请见上请至注册，须在登记时间前送达，信函或邮寄登记均视同 1.2 条所述的证明材料复印件，出席会议时携带原件，公司不接受电话方式办理登记。 （二）登记地点：北京市丰台区丽仁福路 3 号院 1 号楼 6 层九州一轨 625 室 （三）会议登记时间：2026 年 8 月 10 日 14:00-17:00 六、其他事项 （一）本次现场会议出席者食宿及交通自理 （二）会议联系方式： 联系地址：北京市丰台区丽仁福路 3 号院 1 号楼 6 层九州一轨 625 室 联系人：董欢乐 联系电话：010-83882662 传真电话：010-83882662				

北京九州一轨环境科技股份有限公司董事会

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于全资子公司对外投资进行项目建设的议案			
委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托日期： 年月 日 备注： 委托人应在本委托书“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按自己的意思进行表决。 证券代码：688485 证券简称：九州一轨 公告编号：2026-045				

北京九州一轨环境科技股份有限公司关于收购苏州晶禧半导体科技有限公司股权并增资的进展暨全资子公司完成工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州天准科技股份有限公司关于控股股东无偿捐赠股份完成过户暨股东权益变动的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
● 本次无偿捐赠股份已于 2026 年 7 月 28 日在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完成股份过户手续。
● 本次权益变动不会导致苏州天准科技股份有限公司（以下简称“公司”、“天准科技”）控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响。
● 为资助科研教育、科技、人才培养方面的公益项目，为苏州教育和科学事业育才才提供助力，公司控股股东苏州青一投资有限公司（以下简称“青一投资”）与苏州市教育发展基金会于 2025 年 11 月 8 日签署《捐赠协议》，将一投资向苏州市教育发展基金会无偿捐赠其持有的公司股份 1,000,000 股，占公司当前总股本的 0.32%，捐赠股份均为无限流通股。
● 为传承和弘扬科技人文交流和青年创新创业，全力支持全领域范围内的青年投身科学研究事业，推进国际科技人文交流和青年创新创业，全力培养更多未来战略科学家，青一投资与苏州李政道教育和科学基金会于 2025 年 11 月 8 日签署《捐赠协议》，将一投资向苏州李政道教育和科学基金会无偿捐赠其持有的公司股票 6,400,000 股，占公司当前总股本的 3.29%，捐赠股份均为无限流通股。具体内容详见公司于 2026 年 11 月 10 日披露的《苏州天准科技股份有限公司关于控股股东无偿捐赠部分公司股份的公告》（公告编号：2026-062）。

二、股份捐赠进展情况
2026 年 7 月 27 日，青一投资与苏州市教育发展基金会和苏州市李政道教育和科学基金会在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理了非交易过户登记手续。2026 年 7 月 28 日，中国证券登记结算有限公司上海分公司出具了《证券过户登记确认书》。
本次证券过户完成后，公司控股股东青一投资直接持有公司股份 40,000,000 股，占公司当前总股本的 20.54%，青一投资及其一致行动人合计持股 104,300,000 股，占公司当前总股本的 53.56%，青一投资仍为公司控股股东。
（一）控股股东青一投资及其一致行动人持股情况

股东名称/姓名	股份性质	本次捐赠前占比	本次捐赠后占比
青一投资	无限售条件股份	40.000,000	20.54%
李政道基金会	无限售条件股份	34,000,000	17.92%
徐一华	无限售条件股份	30,300,000	15.69%
徐伟	无限售条件股份	13,000,000	6.70%
合计		117,300,000	59.85%

股东名称/姓名	股份性质	本次捐赠前占比	本次捐赠后占比
苏州市教育发展基金会	无限售条件股份	0	0.1,000,000
苏州市李政道教育和科学基金会	无限售条件股份	0	0.6,400,000
合计		0	0.8,000,000

注：上表所涉数据若出现尾数系四舍五入所致。

四、其他说明
1.本次股份捐赠过户登记手续完成后，公司控股股东青一投资持有公司股份 40,000,000 股，占公司当前总股本的 20.54%，仍为公司控股股东。本次捐赠不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响。

2. 苏州市教育发展基金会和苏州市李政道教育和科学基金会承诺：目标的股票完成过户登记之日起十八个月内不减持所持的股票，每年最多可减持的股份，价值不得超过经批准的对应年份的资金预算金额减去年初专项预算金额，如未减持则遵守前项减持的限制。
3.本次股份捐赠涉及《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 16 号——股东及董、高级管理人员减持股份》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、部门规章及规范性文件及《公司章程》的规定，也不存在相关股东因本次权益变动而违反所履行的承诺的情形。
4.本次股份捐赠过户完成后，控股股东及其一致行动人合计持股比例仍为 53.56%，控股股东将根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等有关法规，及时履行信息披露义务，提醒广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州天准科技股份有限公司董事会

2026 年 7 月 29 日

苏州天准科技股份有限公司简式权益变动报告书

一、本次交易事项概述

北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 27 日召开第三届董事会第四次会议，并于 2026 年 4 月 13 日召开 2026 年第二次临时股东大会，审议通过了《北京九州一轨环境科技股份有限公司关于收购苏州晶禧半导体科技有限公司股权并增资暨开展新业务的议案》，公司拟使用自有资金或自筹资金，不超过人民币 41,160 万元的对价购买为限持有的苏州晶禧半导体科技有限公司（以下简称“晶禧半导体”）100% 股权，并于收购完成后向晶禧半导体增资人民币 3,500 万元。本次交易不构成关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2026 年 6 月 10 日，晶禧半导体工商变更手续已完成，并取得了苏州市相城区数据局换发的《营业执照》。本次工商变更完成后，晶禧半导体成为公司全资子公司，并纳入公司合并报表范围。
具体内容详见公司分别于 2026 年 3 月 28 日及 2026 年 6 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京九州一轨环境科技股份有限公司关于收购苏州晶禧半导体科技有限公司股权并增资暨开展新业务的公告》（公告编号：2026-012）、《北京九州一轨环境科技股份有限公司关于收购苏州晶禧半导体科技有限公司股权并增资暨开展新业务的进展暨全资子公司完成工商变更登记的公告》（公告编号：2026-029）及相关公告。

二、本次交易事项进展

2026 年 7 月 27 日，晶禧半导体工商变更手续已完成，并取得了苏州市相城区数据局换发的《营业执照》。公司已完成向晶禧半导体增资人民币 3,500 万元。本次工商变更完成后，晶禧半导体注册资本增加至 6,970 万元。变更后的工商登记信息如下：

1. 公司名称：苏州晶禧半导体科技有限公司
2. 统一社会信用代码：91320506MA8TXX4XXU
3. 注册资本：16,970 万人民币
4. 成立日期：2022 年 7 月 13 日
5. 法定代表人：林辉
6. 住所：江苏省苏州市相城区黄埭镇钱泾路 364 号 9 号楼 1-2 层
7. 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广；集成电路制造；集成电路设计；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；集成电路设计；集成电路芯片及产品销售；电子元器件制造；电子产品材料制造；电子元器件制造；电力电子元器件制造；半导体器件专用设备制造；电子产品制造；科技推广和应用服务；电子产品销售；电子元器件制造；日用玻璃制品制造；日用塑料制品制造；技术玻璃制品销售；机械、机械维修（不含特种设备）；半导体器件专用设备制造；半导体分立器件制造；半导体分立器件销售；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
三、关联交易概述
本次交易完成后，公司将业务运营、管理体系、人员及企业文化等方面与晶禧半导体开展整合与实施工作。由于双方在业务模式、管理机制等方面存在一定差异，后续整合的推进节奏及实施效果存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司将根据整合进度持续完善业务整合工作，促进业务协同发展，并将根据本次交易的后续进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

三、关联交易概述

本次交易完成后，公司将业务运营、管理体系、人员及企业文化等方面与晶禧半导体开展整合与实施工作。由于双方在业务模式、管理机制等方面存在一定差异，后续整合的推进节奏及实施效果存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司将根据整合进度持续完善业务整合工作，促进业务协同发展，并将根据本次交易的后续进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

北京九州一轨环境科技股份有限公司董事会

2026 年 7 月 29 日

北京九州一轨环境科技股份有限公司关于全资子公司对外投资进行项目建设的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
● 投资标的名称：先进半导体晶圆微光隐形切割产业化项目（暂定名称，以下简称“本项目”或“项目”）
● 实施主体：苏州晶禧半导体科技有限公司（以下简称“晶禧半导体”、“子公司”）。晶禧半导体系北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称“九州一轨”、“公司”）的全资子公司；
● 投资规模：本项目预计投资总额不超过人民币 63,000 万元。（含厂房装修改造、设备购买等，具体以实际投资为准）
● 资金来源：包括但不限于自有资金、银行贷款或其他符合法律法规规定的方式，公司及子公司将根据实际资金情况和实施进度进行合理调配。
● 审批程序：本次投资项目已经公司于 2026 年 7 月 28 日召开的第三届董事会战略委员会第三次会议、第三届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司董事会审议。本次投资事项尚须履行主管部门备案审批程序。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组情形。

一、项目概述
（一）项目背景
随着全球半导体行业进入高速增长期，先进制程技术不断突破，市场对高性能、高集成度芯片的需求日益增长。先进制程芯片的制造对光刻、刻蚀、薄膜沉积等工艺提出了更高的要求。先进制程芯片的制造对光刻、刻蚀、薄膜沉积等工艺提出了更高的要求。先进制程芯片的制造对光刻、刻蚀、薄膜沉积等工艺提出了更高的要求。
（二）项目意义
本项目实施后，将进一步提升公司在先进制程芯片制造领域的竞争力，为公司未来在先进制程芯片制造领域的业务拓展提供有力支持。同时，本项目实施后，将进一步提升公司在先进制程芯片制造领域的竞争力，为公司未来在先进制程芯片制造领域的业务拓展提供有力支持。同时，本项目实施后，将进一步提升公司在先进制程芯片制造领域的竞争力，为公司未来在先进制程芯片制造领域的业务拓展提供有力支持。

（三）项目风险
本项目实施过程中，可能面临技术风险、市场风险、资金风险等。公司将密切关注项目进展情况，及时采取有效措施，确保项目顺利实施。同时，公司将根据项目进展情况，及时履行信息披露义务，确保投资者及时了解项目进展情况。

（四）项目后续安排
公司将根据项目进展情况，及时履行信息披露义务，确保投资者及时了解项目进展情况。同时，公司将根据项目进展情况，及时履行信息披露义务，确保投资者及时了解项目进展情况。

（五）项目后续安排
公司将根据项目进展情况，及时履行信息披露义务，确保投资者及时了解项目进展情况。同时，公司将根据项目进展情况，及时履行信息披露义务，确保投资者及时了解项目进展情况。

（六）项目后续安排
公司将根据项目进展情况，及时履行信息披露义务，确保投资者及时了解项目进展情况。同时，公司将根据项目进展情况，及时履行信息披露义务，确保投资者及时了解项目进展情况。

（七）项目后续安排
公司将根据项目进展情况，及时履行信息披露义务，确保投资者及时了解项目进展情况。同时，公司将根据项目进展情况，及时履行信息披露义务，确保投资者及时了解项目进展情况。

（八）项目后续安排
公司将根据项目进展情况，及时履行信息披露义务，确保投资者及时了解项目进展情况。同时，公司将根据项目进展情况，及时履行信息披露义务，确保投资者及时了解项目进展情况。

（九）项目后续安排
公司将根据项目进展情况，及时履行信息披露义务，确保投资者及时了解项目进展情况。同时，公司将根据项目进展情况，及时履行信息披露义务，确保投资者及时了解项目进展情况。

（十）项目后续安排
公司将根据项目进展情况，及时履行信息披露义务，确保投资者及时了解项目进展情况。同时，公司将根据项目进展情况，及时履行信息披露义务，确保投资者及时了解项目进展情况。

（十一）项目后续安排
公司将根据项目进展情况，及时履行信息披露义务，确保投资者及时了解项目进展情况。同时，公司将根据项目进展情况，及时履行信息披露义务，确保投资者及时了解项目进展情况。

（十二）项目后续安排
公司将根据项目进展情况，及时履行信息披露义务，确保投资者及时了解项目进展情况。同时，公司将根据项目进展情况，及时履行信息披露义务，确保投资者及时了解项目进展情况。

（十三）项目后续安排
公司将根据项目进展情况，及时履行信息披露义务，确保投资者及时了解项目进展情况。同时，公司将根据项目进展情况，及时履行信息披露义务，确保投资者及时了解项目进展情况。

（十四）项目后续安排
公司将根据项目进展情况，及时履行信息披露义务，确保投资者及时了解项目进展情况。同时，公司将根据项目进展情况，及时履行信息披露义务，确保投资者及时了解项目进展情况。

（十五）项目后续安排
公司将根据项目进展情况，及时履行信息披露义务，确保投资者及时了解项目进展情况。同时，公司将根据项目进展情况，及时履行信息披露义务，确保投资者及时了解项目进展情况。

（十六）项目后续安排
公司将根据项目进展情况，及时履行信息披露义务，确保投资者及时了解项目进展情况。同时，公司将根据项目进展情况，及时履行信息披露义务，确保投资者及时了解项目进展情况。

（十七）项目后续安排
公司将根据项目进展情况，及时履行信息披露义务，确保投资者及时了解项目进展情况。同时，公司将根据项目进展情况，及时履行信息披露义务，确保投资者及时了解项目进展情况。

（十八）项目后续安排
公司将根据项目进展情况，及时履行信息披露义务，确保投资者及时了解项目进展情况。同时，公司将根据项目进展情况，及时履行信息披露义务，确保投资者及时了解项目进展情况。

（十九）项目后续安排
公司将根据项目进展情况，及时履行信息披露义务，确保投资者及时了解项目进展情况。同时，公司将根据项目进展情况，及时履行信息披露义务，确保投资者及时了解项目进展情况。

（二十）项目后续安排
公司将根据项目进展情况，及时履行信息披露义务，确保投资者及时了解项目进展情况。同时，公司将根据项目进展情况，及时履行信息披露义务，确保投资者及时了解项目进展情况。

（二十一）项目后续安排
公司将根据项目进展情况，及时履行信息披露义务，确保投资者及时了解项目进展情况。同时，公司将根据项目进展情况，及时履行信息披露义务，确保投资者及时了解项目进展情况。

（二十二）项目后续安排
公司将根据项目进展情况，及时履行信息披露义务，确保投资者及时了解项目进展情况。同时，公司将根据项目进展情况，及时履行信息披露义务，确保投资者及时了解项目进展情况。

（二十三）项目后续安排
公司将根据项目进展情况，及时履行信息披露义务，确保投资者及时了解项目进展情况。同时，公司将根据项目进展情况，及时履行信息披露义务，确保投资者及时了解项目进展情况。

（二十四）项目后续安排
公司将根据项目进展情况，及时履行信息披露义务，确保投资者及时了解项目进展情况。同时，公司将根据项目进展情况，及时履行信息披露义务，确保投资者及时了解项目进展情况。

（二十五）项目后续安排
公司将根据项目进展情况，及时履行信息披露义务，确保投资者及时了解项目进展情况。同时，公司将根据项目进展情况，及时履行信息披露义务，确保投资者及时了解项目进展情况。

（二十六）项目后续安排
公司将根据项目进展情况，及时履行信息披露义务，确保投资者及时了解项目进展情况。同时，公司将根据项目进展情况，及时履行信息披露义务，确保投资者及时了解项目进展情况。

芯片、硅衬底，主要客户为光模块厂商和芯片制造商，可为客户提供半导体晶圆高精度图形切割（分割）、开槽、分选等专业业务。
截至本报告书于 2027 年第一季度完成生产性建设并逐步投产，上述建设内容及实施进度均为现阶段规划，最终以项目备案、审批及实际建设运营情况为准。

二、投资事项具体情况
1. 项目基本情况
项目名称：先进半导体晶圆微光隐形切割产业化项目（暂定名称，以下简称“项目”或“项目”）
项目投资者：晶禧半导体、苏州晶禧半导体科技有限公司
项目位置：江苏省苏州市相城区
项目投资金额：项目预计投资总额不超过人民币 63,000 万元。（含厂房装修改造、设备购买等），其中购买设备金额预计不超过 6 亿元
资金来源：包括但不限于自有资金、银行贷款或其他符合法律法规规定的方式，公司及子公司将根据实际资金情况和实施进度进行合理调配。

预计建设周期：项目于 2027 年第一季度完成生产性建设并逐步投产
具体建设内容：项目以高精度图形切割工艺为核心发展主线，专注于领先先进制程半导体加工配套服务。项目建成投产后，可实现 8 英寸、12 英寸硅晶圆及硅衬底全规格加工产能提升，下游核心服务群体包括集成电路与半导体材料上游晶圆厂商，一站式提供晶圆高精度图形切割、晶圆减薄、芯片分选检测等全流程专业化精密加工解决方案。

2. 项目目前建设情况
（一）资金筹措
（二）项目可行性分析
1. 顺应国家集成电路产业政策，助力半导体产业链发展
集成电路产业是信息技术产业的核心，是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性、先导性产业。在 2026 年版的《政府工作报告》中，集成电路产业更是被列为重点支持的新兴支柱产业之一。集成电路制造是一个由多个微细加工工序组成的系统工程，主要包含设计、晶圆制造和封装测试三大环节，其中晶圆制造及分选工序是半导体制造流程中连接晶圆制造环节与封装测试环节的关键工序，其加工质量直接影响封装良率，可靠性以及后续封装的一致性。本项目定位于集成电路产业链配套服务，聚焦先进制程晶圆减薄与分选，完成集成电路产业链闭环。

三、项目未来发展前景
当前，AI 算力与高速通信产业正处于快速发展期，硅光晶圆精密加工作为上游关键环节面临迫切扩大的市场需求。晶禧半导体凭借 99.93% 的良率水平巩固高精度的硅光晶圆微光隐形切割加工能力，已建立与下游晶圆减薄及分选客户长期稳定的战略合作关系，进一步巩固晶禧半导体在硅光晶圆微光隐形切割领域的市场地位，助力晶禧半导体进一步实现长远战略发展，提升核心竞争力。

三、项目未来发展前景
当前，AI 算力与高速通信产业正处于快速发展期，硅光晶圆精密加工作为上游关键环节面临迫切扩大的市场需求。晶禧半导体凭借 99.93% 的良率水平巩固高精度的硅光晶圆微光隐形切割加工能力，已建立与下游晶圆减薄及分选客户长期稳定的战略合作关系，进一步巩固晶禧半导体在硅光晶圆微光隐形切割领域的市场地位，助力晶禧半导体进一步实现长远战略发展，提升核心竞争力。

三、项目未来发展前景
当前，AI 算力与高速通信产业正处于快速发展期，硅光晶圆精密加工作为上游关键环节面临迫切扩大的市场需求。晶禧半导体凭借 99.93% 的良率水平巩固高精度的硅光晶圆微光隐形切割加工能力，已建立与下游晶圆减薄及分选客户长期稳定的战略合作关系，进一步巩固晶禧半导体在硅光晶圆微光隐形切割领域的市场地位，助力晶禧半导体进一步实现长远战略发展，提升核心竞争力。

三、项目未来发展前景
当前，AI 算力与高速通信产业正处于快速发展期，硅光晶圆精密加工作为上游关键环节面临迫切扩大的市场需求。晶禧半导体凭借 99.93% 的良率水平巩固高精度的硅光晶圆微光隐形切割加工能力，已建立与下游晶圆减薄及分选客户长期稳定的战略合作关系，进一步巩固晶禧半导体在硅光晶圆微光隐形切割领域的市场地位，助力晶禧半导体进一步实现长远战略发展，提升核心竞争力。

三、项目未来发展前景
当前，AI 算力与高速通信产业正处于快速发展期，硅光晶圆精密加工作为上游关键环节面临迫切扩大的市场需求。晶禧半导体凭借 99.93% 的良率水平巩固高精度的硅光晶圆微光隐形切割加工能力，已建立与下游晶圆减薄及分选客户长期稳定的战略合作关系，进一步巩固晶禧半导体在硅光晶圆微光隐形切割领域的市场地位，助力晶禧半导体进一步实现长远战略发展，提升核心竞争力。

三、项目未来发展前景
当前，AI 算力与高速通信产业正处于快速发展期，硅光晶圆精密加工作为上游关键环节面临迫切扩大的市场需求。晶禧半导体凭借 99.93% 的良率水平巩固高精度的硅光晶圆微光隐形切割加工能力，已建立与下游晶圆减薄及分选客户长期稳定的战略合作关系，进一步巩固晶禧半导体在硅光晶圆微光隐形切割领域的市场地位，助力晶禧半导体进一步实现长远战略发展，提升核心竞争力。

三、项目未来发展前景
当前，AI 算力与高速通信产业正处于快速发展期，硅光晶圆精密加工作为上游关键环节面临迫切扩大的市场需求。晶禧半导体凭借 99.93% 的良率水平巩固高精度的硅光晶圆微光隐形切割加工能力，已建立与下游晶圆减薄及分选客户长期稳定的战略合作关系，进一步巩固晶禧半导体在硅光晶圆微光隐形切割领域的市场地位，助力晶禧半导体进一步实现长远战略发展，提升核心竞争力。

三、项目未来发展前景
当前，AI 算力与高速通信产业正处于快速发展期，硅光晶圆精密加工作为上游关键环节面临迫切扩大的市场需求。晶禧半导体凭借 99.93% 的良率水平巩固高精度的硅光晶圆微光隐形切割加工能力，已建立与下游晶圆减薄及分选客户长期稳定的战略合作关系，进一步巩固晶禧半导体在硅光晶圆微光隐形切割领域的市场地位，助力晶禧半导体进一步实现长远战略发展，提升核心竞争力。

三、项目未来发展前景
当前，AI 算力与高速通信产业正处于快速发展期，硅光晶圆精密加工作为上游关键环节面临迫切扩大的市场需求。晶禧半导体凭借 99.93% 的良率水平巩固高精度的硅光晶圆微光隐形切割加工能力，已建立与下游晶圆减薄及分选客户长期稳定的战略合作关系，进一步巩固晶禧半导体在硅光晶圆微光隐形切割领域的市场地位，助力晶禧半导体进一步实现长远战略发展，提升核心竞争力。

三、项目未来发展前景
当前，AI 算力与高速通信产业正处于快速发展期，硅光晶圆精密加工作为上游关键环节面临迫切扩大的市场需求。晶禧半导体凭借 99.93% 的良率水平巩固高精度的硅光晶圆微光隐形切割加工能力，已建立与下游晶圆减薄及分选客户长期稳定的战略合作关系，进一步巩固晶禧半导体在硅光晶圆微光隐形切割领域的市场地位，助力晶禧半导体进一步实现长远战略发展，提升核心竞争力。

三、项目未来发展前景
当前，AI 算力与高速通信产业正处于快速发展期，硅光晶圆精密加工作为上游关键环节面临迫切扩大的市场需求。晶禧半导体凭借 99.93% 的良率水平巩固高精度的硅光晶圆微光隐形切割加工能力，已建立与下游晶圆减薄及分选客户长期稳定的战略合作关系，进一步巩固晶禧半导体在硅光晶圆微光隐形切割领域的市场地位，助力晶禧半导体进一步实现长远战略发展，提升核心竞争力。

三、项目未来发展前景
当前，AI 算力与高速通信产业正处于快速发展期，硅光晶圆精密加工作为上游关键环节面临迫切扩大的市场需求。晶禧半导体凭借 99.93% 的良率水平巩固高精度的硅光晶圆微光隐形切割加工能力，已建立与下游晶圆减薄及分选客户长期稳定的战略合作关系，进一步巩固晶禧半导体在硅光晶圆微光隐形切割领域的市场地位，助力晶禧半导体进一步实现长远战略发展，提升核心竞争力。

三、项目未来发展前景
当前，AI 算力与高速通信产业正处于快速发展期，硅光晶圆精密加工作为上游关键环节面临迫切扩大的市场需求。晶禧半导体凭借 99.93% 的良率水平巩固高精度的硅光晶圆微光隐形切割加工能力，已建立与下游晶圆减薄及分选客户长期稳定的战略合作关系，进一步巩固晶禧半导体在硅光晶圆微光隐形切割领域的市场地位，助力晶禧半导体进一步实现长远战略发展，提升核心竞争力。

三、项目未来发展前景
当前，AI 算力与高速通信产业正处于快速发展期，硅光晶圆精密加工作为上游关键环节面临迫切扩大的市场需求。晶禧半导体凭借 99.93% 的良率水平巩固高精度的硅光晶圆微光隐形切割加工能力，已建立与下游晶圆减薄及分选客户长期稳定的战略合作关系，进一步巩固晶禧半导体在硅光晶圆微光隐形切割领域的市场地位，助力晶禧半导体进一步实现长远战略发展，提升核心竞争力。

三、项目未来发展前景
当前，AI 算力与高速通信产业正处于快速发展期，硅光晶圆精密加工作为上游关键环节面临迫切扩大的市场需求。晶禧半导体凭借 99.93% 的良率水平巩固高精度的硅光晶圆微光隐形切割加工能力，已建立与下游晶圆减薄及分选客户长期稳定的战略合作关系，进一步巩固晶禧半导体在硅光晶圆微光隐形切割领域的市场地位，助力晶禧半导体进一步实现长远战略发展，提升核心竞争力。

三、项目未来发展前景
当前，AI 算力与高速通信产业正处于快速发展期，硅光晶圆精密加工作为上游关键环节面临迫切扩大的市场需求。晶禧半导体凭借 99.93% 的良率水平巩固高精度的硅光晶圆微光隐形切割加工能力，已建立与下游晶圆减薄及分选客户长期稳定的战略合作关系，进一步巩固晶禧半导体在硅光晶圆微光隐形切割领域的市场地位，助力晶禧半导体进一步实现长远战略发展，提升核心竞争力。

三、项目未来发展前景
当前，AI 算力与高速通信产业正处于快速发展期，硅光晶圆精密加工作为上游关键环节面临迫切扩大的市场需求。晶禧半导体凭借 99.93% 的良率水平巩固高精度的硅光晶圆微光隐形切割加工能力，已建立与下游晶圆减薄及分选客户长期稳定的战略合作关系，进一步巩固晶禧半导体在硅光晶圆微光隐形切割领域的市场地位，助力晶禧半导体进一步实现长远战略发展，提升核心竞争力。

三、项目未来发展前景
当前，AI 算力与高速通信产业正处于快速发展期，硅光晶圆精密加工作为上游关键环节面临迫切扩大的市场需求。晶禧半导体凭借 99.93% 的良率水平巩固高精度的硅光晶圆微光隐形切割加工能力，已建立与下游晶圆减薄及分选客户长期稳定的战略合作关系，进一步巩固晶禧半导体在硅光晶圆微光隐形切割领域的市场地位，助力晶禧半导体进一步实现长远战略发展，提升核心竞争力。

三、项目未来发展前景
当前，AI 算力与高速通信产业正处于快速发展期，硅光晶圆精密加工作为上游关键环节面临迫切扩大的市场需求。晶禧半导体凭借 99.93% 的良率水平巩固高精度的硅光晶圆微光隐形切割加工能力，已建立与下游晶圆减薄及分选客户长期稳定的战略合作关系，进一步巩固晶禧半导体在硅光晶圆微光隐形切割领域的市场地位，助力晶禧半导体进一步实现长远战略发展，提升核心竞争力。

三、项目未来发展前景
当前，AI 算力与高速通信产业正处于快速发展期，硅光晶圆精密加工作为上游关键环节面临迫切扩大的市场需求。晶禧半导体凭借 99.93% 的良率水平巩固高精度的硅光晶圆微光隐形切割加工能力，已建立与下游晶圆减薄及分选客户长期稳定的战略合作关系，进一步巩固晶禧半导体在硅光晶圆微光隐形切割领域的市场地位，助力晶禧半导体进一步实现长远战略发展，提升核心竞争力。

三、项目未来发展前景
当前，AI 算力与高速通信产业正处于快速发展期，硅光晶圆精密加工作为上游关键环节面临迫切扩大的市场需求。晶禧半导体凭借 99.93% 的良率水平巩固高精度的硅光晶圆微光隐形切割加工能力，已建立与下游晶圆减薄及分选客户长期稳定的战略合作关系，进一步巩固晶禧半导体在硅光晶圆微光隐形切割领域的市场地位，助力晶禧半导体进一步实现长远战略发展，提升核心竞争力。

三、项目未来发展前景
当前，AI 算力与高速通信产业正处于快速发展期，硅光晶圆精密加工作为上游关键环节面临迫切扩大的市场需求。晶禧半导体凭借 99.93% 的良率水平巩固高精度的硅光晶圆微光隐形切割加工能力，已建立与下游晶圆减薄及分选客户长期稳定的战略合作关系，进一步巩固晶禧半导体在硅光晶圆微光隐形切割领域的市场地位，助力晶禧半导体进一步实现长远战略发展，提升核心竞争力。

三、项目未来发展前景
当前，AI 算力与高速通信产业正处于快速发展期，硅光晶圆精密加工作为上游关键环节面临迫切扩大的市场需求。晶禧半导体凭借 99.93% 的良率水平巩固高精度的硅光晶圆微光隐形切割加工能力，已建立与下游晶圆减薄及分选客户长期稳定的战略合作关系，进一步巩固晶禧半导体在硅光晶圆微光隐形切割领域的市场地位，助力晶禧半导体进一步实现长远战略发展，提升核心竞争力。

三、项目未来发展前景
当前，AI 算力与高速通信产业正处于快速发展期，硅光晶圆精密加工作为上游关键环节面临迫切扩大的市场需求。晶禧半导体凭借 99.93% 的良率水平巩固高精度的硅光晶圆微光隐形切割加工能力，已建立与下游晶圆减薄及分选客户长期稳定的战略合作关系，进一步巩固晶禧半导体在硅光晶圆微光隐形切割领域的市场地位，助力晶禧半导体进一步实现长远战略发展，提升核心竞争力。

三、项目未来发展前景
当前，AI 算力与高速通信产业正处于快速发展期，硅光晶圆精密加工作为上游关键环节面临迫切扩大的市场需求。晶禧半导体凭借 99.93% 的良率水平巩固高精度的硅光晶圆微光隐形切割加工能力，已建立与下游晶圆减薄及分选客户长期稳定的战略合作关系，进一步巩固晶禧半导体在硅光晶圆微光隐形切割领域的市场地位，助力晶禧半导体进一步实现长远战略发展，提升核心竞争力。

三、项目未来发展前景
当前，AI 算力与高速通信产业正处于快速发展期，硅光晶圆精密加工作为上游关键环节面临迫切扩大的市场需求。晶禧半导体凭借 99.93% 的良率水平巩固高精度的硅光晶圆微光隐形切割加工能力，已建立与下游晶圆减薄及分选客户长期稳定的战略合作关系，进一步巩固晶禧半导体在硅光晶圆微光隐形切割领域的市场地位，助力晶禧半导体进一步实现长远战略发展，提升核心竞争力。

三、项目未来发展前景
当前，AI 算力与高速通信产业正处于快速发展期，硅光晶圆精密加工作为上游关键环节面临迫切扩大的市场需求。晶禧半导体凭借 99.93% 的良率水平巩固高精度的硅光晶圆微光隐形切割加工能力，已建立与下游晶圆减薄及分选客户长期稳定的战略合作关系，进一步巩固晶禧半导体在硅光晶圆微光隐形切割领域的市场地位，助力晶禧半导体进一步实现长远战略发展，提升核心竞争力。